



KMT-8201 LED 环氧封装胶饼

产品用途

KMT-8201 环氧胶饼用于 LED 的热注塑型封装。

产品特性

1. 优异的流动特性可满足多种封装条件
2. 低应力使得产品在高温下拥有很好地韧性、固化收缩率等特性
3. 用于 LED 封装时拥有良好的适用性和可靠性

封装时注意事项

KMT-8201 不同于传统的 EMC 封装材料，在使用前一定要严格遵守如下要求。

回温

KMT-8201 从冷库中取出后，材料必须在温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度为 $40\pm 15\%$ 的环境下闭口放置不少于 24 小时至工作环境后方可打开使用，避免环境温差导致材料吸水。

预热

KMT-8201 材料在投入注塑压机前需要使用红外加热机对胶饼进行预热，严格控制加热温度和时间，使胶饼内外温度相同。

封装条件

KMT-8201 需要配合外脱模剂（有机硅或氟化合物）一起使用，以获得优异的脱模性能。不同的封装模具设计、芯片结构可能需要使用不同的封装条件。一般推荐 KMT-8201 在使用时采用如下封装条件。

项目	单位	参数范围
预热温度	$^{\circ}\text{C}$	75-95
固化温度	$^{\circ}\text{C}$	150-170



版本: K01141223

KMT-8201 LED 环氧封装胶饼

固化压力	MPa	3-8
转进时间@150°C	sec	40-60
固化时间@150°C	sec	150-240
后固化时间@150°C	hours	3-4

使用要求

在使用KMT-8201之前, 模具必须经过彻底清洗和喷脱模剂。当进行封装时, 建议前三模固化5-10分钟, 以补偿清模时造成的模具和注塑头的温度降低。固化时间的增加也是为了确保浇口和排气口完整脱模, 以免污染模具, 影响后续封装生产。

产品性能

KMT-8201在实验室150°C成型时间为4分钟、150°C后固化时间为4小时的条件下列得产品性能如下:

产品性能	测试条件	单位	参数	备注
硬 度	Shore D	-	Min 80	@25°C
凝胶化时间		sec.	35-50	@150°C
螺旋流动长度		cm	100-160	@150°C
固化收缩率	JIS K 6911	%	Max 1.5	
玻璃化转变温度		°C	Min 100	@TMA
热膨胀系数 α_1		$10^{-5}K^{-1}$	6-10	
热膨胀系数 α_2		$10^{-5}K^{-1}$	17-21	
弯曲强度		MPa	Min 110	
弯曲模量		GPa	2.6-3.4	
比 重		-	1.2-1.25	
400nm透光率		Spectrophotometer	%	Min 85

以上数据在实验室测得, 不能保证数据广泛有效性



版本: K01141223

KMT-8201 *LED 环氧封装胶饼*

包装储存

KMT-8201 可以根据客户需求, 采用特定尺寸和重量的饼料提供方式。饼料包装, 10Kg/纸箱。

KMT-8201 粉料或饼料必须储存在冷库或冰柜中, -10°C 以下密封保存六个月。

声明: 北京康美特科技有限公司拥有此产品说明书的最终解释权, 未经北京康美特科技有限公司许可, 任何公司和个人不得引用和泄露说明书内容。